

5663BK

日期：05/2025

应用介绍

特点

一款单组份环氧树脂胶，加热固化，具有中等粘度、高 Tg、低 CTE、耐高温高湿等特点；可填充较小缝隙，有较高耐候性及稳定可靠性；适用于电子芯片及元器件底部填充及周边保护粘接

粘接材料

金属，陶瓷，塑料/PCB，玻璃等

典型应用

电子元器件底部填充保护

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	5000-10000	2rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件*	10mins@150℃或 20mins@130℃或 60mins@100℃	
有效期@-20℃，月	6	

*固化温度是指达到胶水表面的实际温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	88-95D	ASTM D-2240
玻璃化温度 Tg	≥125℃	TMA
热膨胀系数	$\alpha_1=34\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (<Tg) $\alpha_2=114\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (>Tg)	
可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1%	
工作温度范围*	-55℃—150℃	

储存和使用方法

产品需低于-20℃环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 或 55ml 包装至少回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件。

注：

1. 本技术数据表（TDS）中提供的信息和应用建议是基于 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知客户关于内容的更改。

